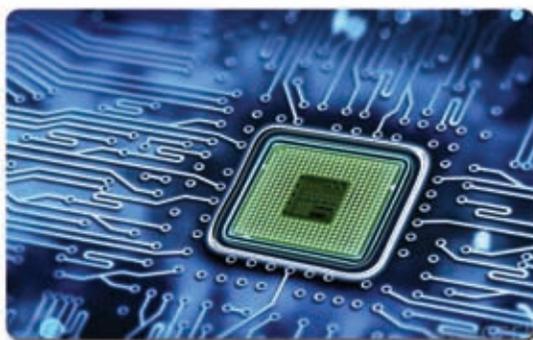
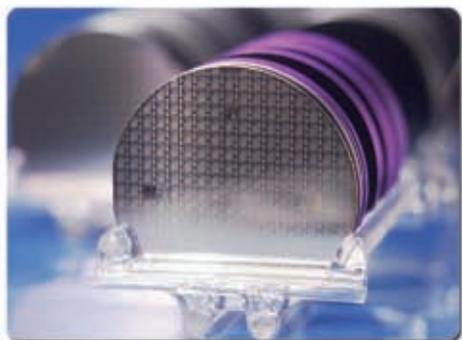


中国半导体大硅片发展论坛 **2018**

China Large Silicon Wafer Forum

10.25-26 苏州 Suzhou



主办
Organizer



ASIACHEM®



中国半导体大硅片发展论坛

China Large Silicon Wafer Forum

2018

苏州 Suzhou
10.25-26

会议背景

2017年，中国集成电路进口金额2600亿美元，远超石油进口额。2014年出台《国家集成电路产业发展推进纲要》，并成立国家集成电路产业基金，体现了政策的高度重视。

硅片是集成电路的主要原材料。2017年，全球晶圆制造材料市场规模260亿美元，其中硅片市场规模76亿美元，占比近30%。在规模生产过程中，长晶是最核心的工序。单晶生长技术路线主要分为直拉法和区熔法。

目前主流的硅片为300mm（12英寸）和200mm（8英寸）。硅片供应商主要有日本信越、SUMCO、环球晶圆、德国Silitronic、韩国SK Siltron等，前五大厂商合计市场占有率超过90%。而中国12英寸硅片几乎全部依赖进口，8英寸硅片也只有少数厂商可以供应。大硅片国产化已是迫在眉睫。

目前在积极规划大硅片生产的主要有Ferrotec、合晶科技，以及中国的金瑞泓、超硅、奕斯伟、上海新昇等。正在规划中的12英寸硅片的总设计产能超过120万片/月。电子级多晶硅是硅片生产所需要的关键材料。全球电子级多晶硅重要企业有瓦克(Wacker), OCI, REC, Hemlock, Tokuyama等。当前，中国电子级多晶硅主要依赖进口。江苏鑫华与黄河水电等少数企业开始生产。实现电子级多晶硅国产化，是中国未来发展的必然趋势。

由亚化咨询主办的首届**中国半导体大硅片发展论坛**将于**2018年10月25-26日**在**苏州**召开。会议将重点探讨中国集成电路产业政策与市场前景；晶圆对大硅片的需求；大硅片项目规划与建设进展；大硅片供需与价格趋势；大硅片制造技术与关键材料；电子级多晶硅的国产化与工艺技术与创新；电子级多晶硅项目规划；电子级多晶硅与大硅片一体化等。

会议主题

- 中国集成电路产业政策与市场前景
- 晶圆对大硅片的需求
- 全球以及中国大硅片市场供需分析
- 中国生产大硅片面临的机遇、挑战与解决方案
- 中国大硅片项目规划与建设进展
- 大硅片制造技术与关键材料
- 电子级多晶硅的国产化与工艺技术创新
- 电子级多晶硅项目规划
- 晶圆与大硅片对电子级多晶硅的要求
- 相关技术创新：区熔硅单晶、硅芯制备、硅片清洗
- 电子级多晶硅与大硅片一体化
- 半导体园区与企业参观（待定）

日程安排

2018年10月24日 周三

16:00~21:00 会前注册

2018年10月25日 周四

09:00~12:30 演讲报告

12:30~14:00 自助午餐与交流

14:00~18:30 演讲报告

18:30~20:00 招待晚宴

2018年10月26日 周五

09:00~14:00 园区参观

咨亚
询化 ASIACHEM®

中国大硅片与电子级多晶硅项目分布图

硅片生产企业	项目地点	8英寸设计产能 (万片/月)	12英寸设计产能 (万片/月)
金瑞泓	衢州	40	10
重庆超硅	重庆	50	5
成都超硅	成都	N/A	25
奕斯伟	西安	N/A	N/A
立昂微电子	衢州	N/A	30
宁夏银和	银川	30	20
Ferrotec (中国)	杭州	45	24
中环半导体	天津	30	2
中环联合晶盛机电	无锡	75	60
上海新昇	上海	N/A	60
保利协鑫	N/A	N/A	N/A

